

安全评价报告信息公开表格（宝鼎乾芯集成电路（杭州）有限公司）

被评价单位名称		宝鼎乾芯集成电路（杭州）有限公司	
评价项目名称/项目编号		宝鼎乾芯集成电路（杭州）有限公司6英寸半导体集成电路制造生产线一期项目安全验收评价/第2205025号	
项目简介（含图片）	<p>项目为计算机、通信和其他电子设备制造业厂房,用于生产6英寸晶圆产品,本次验收规模年产36万片。新增地上建筑面积89912.16m², 新增地下建筑面积5381.29m²。该项目涉及的建（构）筑有: FAB 厂房, 动力站, 丙类库, 甲类库, 氢气站, 大宗气体站, 柴油罐、垃圾站, 主、次门卫等。宝鼎乾芯集成电路（杭州）有限公司6英寸半导体集成电路制造生产线一期项目位于浙江省杭州市钱塘新区东围路598号, 根据现场调查, 本项目所在地块东侧为规划地; 南侧为江东七路, 隔路为2025（中国）智造谷; 西侧为规划地; 北侧为滨江二路, 隔路为河流。</p>		
			
			
安全评价机构名称		浙江道宇安环科技有限公司	
项目组长		夏宇科	
技术负责人		蒋永成	
过程控制负责人		吴芳萍	
评价报告编制人		夏宇科、汪胜红	
报告审核人		张卫兴	
参与评价工作	安全评价师	袁福江、汪胜红、张奇峰、段建勇、夏宇科	
	注册安全工程师	袁福江、汪胜红、张奇峰、段建勇、夏宇科	
	技术专家	/	
现场开展安全评价工作	人员	夏宇科、汪胜红	
	时间	2024.11.13—2024.12.14	
	主要任务	资料收集、现场检查、编制报告	
评价报告提交时间		2024.12.14	